

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中邮证券、金鹰基金、华安基金、国联基金、光大证券、兴银理财、国泰基金、长城基金、景顺长城基金、平安基金、创金合信基金、申万宏源证券、财通基金、中金资管、恒生前海基金、海南挚盛投资、东北证券、开源证券、方正证券、国金证券、国联民生证券、国泰海通、华泰证券、上海银行、德蓝资管、航行资本、长信基金、华福证券、东方财富证券、浙商证券、宝盈基金、厦门中略投资、point72、上海人寿、太平养老保险、长盛基金、昆仑信托、中信证券、平安证券、银河证券、天风证券、唐臣投资、源乘投资、红土创新、浙商资管、国都自营、金建投资、高腾国际、航长投资、红杉资本、象舆行投资、鑫焱投资、方物基金、禹田资本、明河投资、广发自营、中银证券、标朴投资、东方自营
时间	2026年4月26日-2026年4月28日
地点	电话会和公司
上市公司接待人员姓名	总经理：向文胜 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 财务总监：吕敏 合规总监：李璠媛

	<p>证券事务代表：徐雯</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司管理层介绍 2025 年年度和 2026 年一季度经营情况</p> <p>2025 年公司实现营业收入 5.93 亿元，同比增长 37.13%；归母净利润 5,123.78 万元，同比增长 53.05%；扣非净利润 4,700.36 万元，同比增长 92.71%，盈利质量显著提升。为积极回报股东，同时兼顾公司中短期的资本开支和经营性现金需求，董事会提议：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。</p> <p>进入 2026 年，公司继续保持稳健增长态势。一季度实现营业收入 1.62 亿元，同比增长 28.07%；归母净利润 941.65 万元，同比增长 24.50%。需要说明的是，一季度研发支出同比增长接近 40%，同时还有股份支付费用，对当期净利润产生了一定影响。如果剔除股份支付的影响，一季度净利润为 1,310.53 万元，同比增长 73.26%。整体来看，一季度情况符合公司预期。随着高毛利产品进一步量产出货，公司的整体盈利水平还会持续提升。</p> <p>公司两大业务，首先光刻胶业务方面，艾森目前是国内唯一一家能够提供先进封装光刻胶全品类国产替代的厂商，也是在 2.5D、3D 等最新封装形式上，主力客户最核心的供应商。过去，光刻胶的需求主要跟随着封装产量线性增长，但是现在，AI 芯片带动 HBM 从 8 层、12 层向 16 层的演进，每一层 DRAM 堆叠都需要独立的光刻工艺。层数翻倍，光刻次数也随之翻倍，光刻胶的用量呈现出超线性爆发的态势。因此，光刻胶的业务是公司未来几年的核心增长点，也是公司产能布局的重中之重。在现有产能基础上，我们刚刚发布了可转债预案，募集资金将重点投向光刻胶及配套树脂的新产能基地的建设。当然国内的 2.5D、3D，包括 HBM，目前还是刚刚起步的阶段，随着未来中国市场的份额逐渐提升，我们的产品也会实现快速增长的趋势。</p> <p>在湿电子化学品方面，半导体材料国产替代正从长期逻辑走向加速兑现。公司用于 28 纳米以下铜制程及钴制程的电镀液、清洗液等产品，已经陆续进入规模化供应阶段，同时也在向存储芯片厂商重点突破。目前国内能够提供先进制程湿电子化学品的厂商还很少，晶圆厂的验证导入要求非常严格，公司基本上都处于优先顺位，为后续放量、形成规模化收入创</p>

造了很好的条件。

二、问答交流环节

问题一：在玻璃基板方面，有哪些产品进行供应的？

答：公司 TGV 镀铜添加剂应用于玻璃基板通孔技术中，目前正在配合头部玻璃基板客户进行测试。负性光刻胶已成功拓展至玻璃基封装应用场景，获得头部客户量产订单。此外，低温负性 PSPI 及专用于狭缝涂布的低粘度版产品，将进一步助力玻璃基封装与玻璃载板 TGV 技术的发展。

问题二：低温 PSPI 这个产品用量？以及后续的这款产品的增长情况，客户导入的情况？

答：公司自研适用于先进封装领域的低温 PSPI，近期已拿到客户的订单。这款低温 PSPI 可作为核心绝缘和介电材料，应用于扇外型晶圆级封装、2.5D/3D 封装等，作为 RDL 绝缘层、TSV 侧壁钝化与填充、晶圆级封装 (WLP) 中的钝化层、缓冲层和保护膜。低温 PSPI 是 AI 芯片先进封装的关键材料之一，目前仍由美日企业高度垄断，国产替代潜力巨大。

公司在先进封装 PSPI 领域实现了高温、低温、超低温全系列产品布局。但由于 PSPI 系保留材，因此产品实现规模化收入之前，需经过长时间的可靠性验证，以及向芯片设计公司完成供应链物料的切换申请。因此，相较于光刻胶，PSPI 产品的导入速度较慢，但公司在先进封装及晶圆厂领域均已取得靠前的行业顺位与市场卡位，未来有望获取较大的市场份额。

问题三：PSPI 在存储那边有测吗？

答：公司自研的 PSPI 产品可应用于存储芯片，正在积极与存储领域客户进行技术交流。

问题四：今年对整体先进封装的市场规模是怎么展望的？产品在先进封装客户端的进展如何？

答：先进封装客户端稼动率数据反映出先进封装行业整体仍处于持续

	<p>景气阶段。就公司产品而言：</p> <p>公司的光刻胶产品已完成技术积累并具备量产基础，当前核心任务为加速市场渗透。基于现有业务进展及行业需求趋势，公司对光刻胶板块全年表现持积极乐观预期：2025 年光刻胶收入 3,030.72 万元，增长动力主要来自先进封装领域的需求放量，后续随着产品认可度提升及堆叠工艺对光刻胶用量的超线性需求，有望实现更快速增长。</p> <p>作为先进封装电镀液及光刻胶配套试剂的主力供应商，公司在国内市场占据核心地位，相关业务与行业 β 高度绑定，业务收入将随着先进封装行业的景气度及稼动率保持稳步增长。</p> <p>问题五：马来西亚子公司去年是 4,000 多万的营收，主要是哪些品类构成，以及今年业务展望，会新增哪些客户？</p> <p>答：2025 年，公司马来西亚子公司实现收入 4,476.84 万元，占公司合并报表总营收比例约 8%，客户覆盖 X-Fab、HP 等国际大厂，以及日月光、长电科技等头部企业的东南亚工厂，产品主要为湿电子化学品。</p> <p>展望未来，马来西亚业务的增速有望超过国内主体。主要依据包括： （1）马来西亚子公司已实现从渠道代理向本地化制造与服务的整合，未来将进一步建立起完善的本地研发能力，以快速响应客户的定制化需求，从而在马来西亚本土材料商中脱颖而出，构建竞争壁垒； （2）自艾森股份完成对马来西亚子公司的收购后，马来西亚子公司可以依托艾森在国内先进封装领域深厚的客户基础，在国内头部封装企业在东南亚的布局产能中较快实现产品导入。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 4 月 28 日